

机械设备行业跟踪周报

推荐高景气和国产化率加速的半导体设备； 建议关注人形机器人龙头企业模型端进展

增持（维持）

2026 年 08 月 09 日

证券分析师 周尔双

执业证书：S0600515110002

021-60199784

zhouersh@dwzq.com.cn

证券分析师 李文意

执业证书：S0600524080005

liwenyi@dwzq.com.cn

证券分析师 韦译捷

执业证书：S0600524080006

weiyj@dwzq.com.cn

证券分析师 黄瑞

执业证书：S0600525070004

huangr@dwzq.com.cn

研究助理 陶泽

执业证书：S0600125080004

taoz@dwzq.com.cn

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

2.投资要点：

【人形机器人】宇树科技完成 IPO 询价，模型端进展推动产业化 0-1 进程

8月6日，宇树科技科创板 IPO 询价确定发行价为 150.80 元/股，公开发行 4,044.64 万股（发行后总股本 4.04 亿股），预计募资约 61 亿元（超募近 19 亿元），对应发行市值约 609.93 亿元。战略配售方引入 DeepSeek、腾讯旗下启善投资等产业资本，旨在推进 AI 大模型与具身智能的技术协同。2026 年 H1 公司预计营收 10.90 亿元，同比 +40.52%；归母净利润 2.82 亿元，同比扭亏为盈，较上年同期增加 3.14 亿元；扣非归母净利润 2.60 亿元，同比 -14.20%，公司四足机器人与人形机器人出货均在快速增长，本次 IPO 募资重点投向模型端开发，软硬件同步推动发展助力人形机器人尽早实现产业化 0-1 落地。

7月30日，Google DeepMind 正式发布新一代机器人基础模型系列 Gemini Robotics 2。核心突破在于首次以单一 VLA 模型实现人形机器人从脚趾到指尖的全身自由度协同控制，打破了传统行走与操作分离的拼接式架构。在 Apptronik Apollo 2 机器人上，系统已完成跨房间行走、抓取放置、拧灯泡、密封夹链袋等复杂任务，并支持异构机器人团队协作。该发布验证了通用模型跨硬件适配的技术可行性，强化了机器人产业软硬件解耦的“安卓生态”商业模式，显著降低了新机型开发门槛与适配成本，对加速人形机器人从实验室走向工业制造、仓储物流等真实场景的规模化落地具有重要推动意义。建议关注：宇树链核心【首程控股】【美湖股份】【中大力德】【长盛轴承】；银河通用链核心【天奇股份】；T 链【恒立液压】【三花智控】【拓普集团】【浙江荣泰】【五洲新春】；谐波用量预期上修【绿的谐波】【斯菱股份】；灵巧手板块【兆威机电】【汉威科技】【新坐标】。

【半导体设备】海外半导体设备业绩加速放量，继续看好国产设备商

先进逻辑&存储共振。海外半导体设备业绩持续超预期兑现。1、ASML FY26Q2 净利润 29.18 亿欧元，同比+27%；期间存储客户收入同比+84%。2、爱德万 FY26Q1 实现净利润 1748 亿日元（约 72 亿元人民币），同比 +94%。3、TEL FY27Q1 实现净利润同比 +40%。4、LAM FY26Q4 实现净利润 22.8 亿美元，同比 +32%。

AI 驱动海外半导体设备高景气，国产设备将受益于行业 beta&国产替代双重逻辑。海外 AI 加速海外玩家业绩兑现，我们认为，AI 驱动下国产算力将快速发展，带来先进制程、先进封装设备新需求，不管是先进逻辑还是长存、长鑫等先进产能都在积极扩产；SoC 芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；COWOS、HBM 等先进封装技术快速发展。

投资建议：（1）前道制程：刻蚀/薄膜沉积设备北方华创、中微公司、迈为股份，量测设备中科飞测、精测电子，薄膜沉积设备拓荆科技、微导纳米、晶盛机电等。（2）后道封装：长川科技、华峰测控。（3）先进封装：拓荆科技（键合机）、华海清科（减薄机）、盛美上海（电镀机）、芯源微（涂胶显影+键合机）、迈为股份（切磨抛+键合机）、晶盛机电（减薄机）。（4）硅光设备：罗博特科、奥特维（AOI 检测设备）。

【PCB 设备】超颖电子再出扩产计划，PCB 厂资本开支有望持续超预期

8月7日，超颖电子公告持续扩产以及增加资本开支计划：①拟投资 20.9 亿元建设高多层及 HDI 印刷电路板 P3 项目；②计划公司及子公司进一步合计发生约 19.16 亿元资本性支出，具体包括设备采购与改良。除超颖电子外，鹏鼎、红板、胜宏、沪电、深南、广合、兴森等板厂近期也密集出台融资或投资计划，真实反应行业景气度。我们判断 PCB 厂后续扩产规划有望持续超预期，设备端最为受益。我们认为 2028 年 AI PCB 总市场空间有望持续超预期，主要系除服务器内 PCB 规格持续升级与服务器出货持续增长以外，光模块、NPO、交换机等场景同样需要配套高端 PCB，总市场空间有望伴随算力建设加速与工艺升级持续扩张。现阶段板厂扩产主要方向均为 mSAP 工艺类载板或 HDI 板，专门贴合 AI 算力建设需求场景。PCB 工艺升级对设备端提出更高要求：①钻孔设备：孔径进一步缩小，超快激光钻成为相比 CO2 激光钻的更优选择；②曝光设备：线宽线距要求进一步缩窄，LDI 设备精度要求提升；③电镀设备：需要镀铜更加精细化的 VCP 电镀设备；④成型设备：需要使用 CCD 锣机以实现更精准的分板。另外 HDI 板在英伟达算力服务器计算托盘中应用较多，且未来伴随互联密度提升，HDI 有望逐步提高渗透率替代高多层板应用的场景。相比于高多层板，HDI 重点突出增层盲埋孔加工工艺升级，生产端对激光钻孔机有较多增量需求。AI 算力配套使用的 PCB 持续高端化发展，设备端存在通胀逻辑，最为受益。投资建议：PCB 设备&耗材重点推荐【大族数控】【芯碁微装】【东威科技】【凯格精机】【鼎泰高科】【中钨高新】【新锐股份】【欧科亿】，建议关注【民爆光电】。

行业走势



相关研究

《半导体设备：SK 海力士业绩超市场预期，看好国内长鑫 HBM 扩产利好先进封装设备商》

2026-05-11

《PCB 设备 2025 年报&2026 年一季报总结：业绩兑现元年，关注技术通胀带来的非线性增长》

2026-05-13

【工程机械】7月挖机出口销量同比+21%，建议关注板块低位布局机会

2026年7月挖掘机销量19521台，同比增长13.9%。其中国内销量7608台，同比增长4.13%；出口11913台，同比增长21.2%，出口延续上半年高增长。板块国内市场由更新需求驱动，挖机及非挖设备销量保持较强韧性；海外市场虽然部分区域增速可能因为基数提升而放缓，但非洲、拉美、东南亚等市场需求仍较旺盛，矿山机械也有望成为下一阶段的重要增长点。当前龙头公司估值已处于历史偏低水平，板块迎来低位配置窗口。重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压，建议关注艾迪精密。

【高空作业平台】北美AI基建景气度高，龙头业绩触底反转

近日北美高机双龙头披露半年报，营收、订单均迎向上拐点：(1)JLG：Q2 Access 事业部实现营收14亿美元，同比增长9%；新签订单同比增长133%，在手订单同比增长65%。(2)Genie收入7亿美元，同比增长11%，并将全年AWP事业部的收入预期从持平上调至低双位数增长。但是受关税影响，两家公司利润率均有所下滑。此前北美最大租赁商URI业绩同样超预期：Q2租赁收入38.5亿美元，同比增长13%，净利润7.5亿美元，同比增长21%，均创历史新高；单Q2资本开支19.5亿美元，同比增长34%，且上调全年开支至47.5-53.5亿美元（上调幅度10%），中值50.5亿美元，同比增长21%，且公司认为北美大型项目建设需求将持续至2027年后（年初至今DMI>250保持历史高位，可与此拟合、交叉验证）。北美高机龙头、头部租赁商业绩改善、上修预期，反映AI基建需求旺盛，推荐低估值高机龙头【浙江鼎力】，对美敞口较高的【中力股份】；建议关注受益海外电力基建需求的【优利德】。

【船舶行业】龙头拟翻倍招工，造船高景气延续、标的兑现提速

2026年上半年，恒力重工用工人数已达11万人；8月4日，公司宣布于下半年再招聘10万名产业工人，为三、四期产能建设及后续产能爬坡提供人力保障。2026年上半年公司预计实现归母净利润36亿元，同比增长456%；订单端，同期新签订单207艘（全球份额约14%），其中散货船/集装箱船/油轮/VLAC分别49/56/94/8艘，高端船型集装箱、油轮占比提升明显，有望带动盈利中枢继续上移。随订单结构优化及新增产能逐步投产，公司业绩有望加速释放。龙头扩产提速反应行业景气度高，推荐中船集团旗下船舶总装上市平台【中国船舶】、船舶动力系统核心标的【中国动力】。

风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。

内容目录

1. 建议关注组合5

2. 近期报告5

3. 核心观点汇总5

4. 行业重点新闻16

5. 公司新闻公告17

6. 重点高频数据跟踪19

7. 风险提示21

图表目录

图 1: 2026 年 7 月制造业 PMI 为 49.2%，环比下降 1.1pct..... 19

图 2: 2026 年 6 月制造业固定资产投资完成额累计同比-1.2%..... 19

图 3: 2026 年 6 月金切机床产量 9.0 万台，同比+18%..... 19

图 4: 2026 年 6 月新能源乘用车销量 100.7 万辆，同比-9%（单位：辆）..... 19

图 5: 2026 年 7 月挖机销量 2.0 万台,同比+14%（单位:台）..... 20

图 6: 2026 年 6 月国内挖机开工时长为 58.1 小时，同比-10%（单位：小时）..... 20

图 7: 2026 年 6 月动力电池装机 76.5GWh,同比+31%..... 20

图 8: 2026 年 5 月全球半导体销售额 1206.1 亿美元，同比+104%..... 20

图 9: 2026 年 6 月工业机器人产量 11.1 万套，同比+28%..... 20

图 10: 2026 年 6 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.5 万台,同比+9%..... 20

图 11: 2026 年 6 月全球集装箱船/油船/散货船新接订单量同比分别+53%/+291%/+21% 21

图 12: 2026 年 6 月我国船舶新承接/手持订单同比分别+238%/+41%..... 21

表 1: 建议关注组合..... 5

1. 建议关注组合

表1: 建议关注组合

所处领域	建议关注组合
光伏设备	晶盛机电、HJT 整线设备龙头、捷佳伟创、奥特维、双良节能、帝尔激光、高测股份、金博股份、罗博特科、金辰股份
半导体设备 & 零部件	北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、中科飞测、精测电子、长川科技、富创精密、芯源微、华峰测控、先导基电、新莱应材、华兴源创、英杰电气、汉钟精机、至纯科技、正帆科技、赛腾股份、神工股份
工程机械	三一重工、恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、安徽合力、艾迪精密、柳工、山推股份、中国龙工
通用自动化	怡合达、埃斯顿、绿的谐波、海天精工、秦川机床、国茂股份、创世纪、伊之密、华中数控、科德数控、纽威数控、华锐精密、华辰装备、欧科亿、国盛智科、新锐股份
锂电设备	璞泰来、先导智能、杭可科技、赢合科技、东威科技、曼恩斯特、海目星、骄成超声、联赢激光、洪田股份、利元亨、先惠技术
油气设备	中海油服、杰瑞股份、海油工程、中密控股、纽威股份、石化机械、博迈科
激光设备	柏楚电子、锐科激光、杰普特、德龙激光
检测服务	华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、安车检测
轨交装备	中国中车、中铁工业、思维列控、康尼机电
仪器仪表	普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德
船舶集运	中国船舶、中国动力、中集集团、中远海发

数据来源: Wind, 东吴证券研究所整理

2. 近期报告

【半导体设备行业】深度报告: AI 发展带动 HBM 需求爆发, 看好半导体设备商充分受益

【AIDC 发电行业】深度报告: 缺电逻辑下燃机已开始释放利润, 重视 0-1 的 SOFC

【半导体设备行业】点评报告: 爱德万 FY26Q1 业绩验证行业高景气, 看好国产测试龙头复制其成长路径

3. 核心观点汇总

【半导体设备行业】深度报告: AI 发展带动 HBM 需求爆发, 看好半导体设备商充分受益

AI 驱动 HBM 需求爆发, DRAM 供需持续偏紧, 全球存储进入新一轮扩产周期。AI 训练及推理需求持续增长, 推动 GPU、ASIC 等 AI 芯片出货量快速提升, 同时单芯

片 HBM 容量、堆叠层数及带宽持续升级，HBM 需求呈现量价齐升趋势。我们测算，全球 HBM wafer 需求将由 2024 年的 2.9 万片/月增长至 2028 年的 44.2 万片/月，年均复合增速超过 90%。由于 HBM 持续挤占传统 DRAM 晶圆产能，AI 对存储的挤出效应未来两年内仍难缓解，全球 DRAM 供需仍将维持紧平衡，国内外存储厂商扩产需求具备较强持续性。

HBM 带动存储制程升级，设备投资额与资本开支同步提升。随着 HBM 向 HBM4、HBM4E 持续演进，DRAM 制程不断升级，3D NAND 同步向更高层数发展，先进存储单位产能对应设备投资额持续提升。与此同时，为满足高带宽、高堆叠、高良率要求，刻蚀、薄膜沉积、量检测等关键工艺的重要性进一步提高，设备数量及工艺复杂度同步增加。我们测算，薄膜、刻蚀及量测设备合计占存储设备资本开支超过 50%，将充分受益于本轮存储扩产周期。

国内外存储同步扩产，平台化设备龙头及核心环节有望持续受益。海外三星、SK 海力士、美光持续加大 HBM 及先进 DRAM 产能投入，国内长鑫存储、长江存储扩产节奏同步加快，国产存储市占率有望持续提升。随着存储景气度回升及新一轮资本开支开启，平台化设备商将凭借产品覆盖度持续提升率先受益，同时薄膜沉积、刻蚀、量检测等高价值量环节也将迎来更大的成长空间，看好具备平台化能力及国产替代优势的设备龙头长期成长。

投资建议：看好前后道半导体设备+零部件厂商，重点推荐前道设备【北方华创】【中微公司】【迈为股份】【芯源微】【屹唐股份】【中科飞测】【精测电子】【天准科技】【拓荆科技】【微导纳米】【先导基电】【华海清科】【盛美上海】【晶盛机电】；后道设备【长川科技】【华峰测控】；材料和零部件环节【富创精密】【新莱应材】【英杰电气】【汉钟精机】【晶盛机电】；建议关注后道设备【联讯仪器】【精智达】【联动科技】。

风险提示：半导体行业投资不及预期，设备国产化进程不及预期，技术迭代及工艺路线变化风险。

【AIDC 发电行业】深度报告：缺电逻辑下燃机已开始释放利润，重视 0-1 的 SOFC

“三减一增”重塑北美电力供需格局，全球发电设备供需缺口有望长期存在。增量端，AI 机柜出货及单柜功耗快速提升，叠加 PUE、冗余配置与有限的并网能力，我们预计 2024-2030 年北美 AIDC 新增电力设备需求分别约 6.1/20.4/19.7/29.3/37.5/48.1/57.5 GW，“一增”累计达到 218GW。存量端，我们预计 2026-2030 年美国煤电、核电及老旧燃机分别退出 86/95/91.5GW，“三减”合计约 272.5GW，形成存量替换打底+AIDC 增量加持的双轮驱动。同期全球可用于 AIDC 的发电设备供给虽将由 2024 年的 6.8GW 提升至 2030 年的 94.0GW，但仍难覆盖快速增长的新增需求，我们预计 2024-2030 年累计供需缺口

约 218.7GW，电力设备紧缺及价格上行有望长期延续。

多维约束驱动 AIDC 电源选型，重视燃机+SOFC 业绩确定性。重燃全生命周期度电成本约 0.063 美元/kWh，为各类现场发电路径最低，且具备规模化供电能力强、技术成熟及运行寿命长等优势，仍是大型 AIDC 长期基荷供电的核心方案；SOFC 兼具高效率、低污染、模块化部署等优势，在环保许可趋严和 AIDC 大型化背景下渗透率有望加速提升；轻燃与燃气内燃机则更适合桥接电源、分期投产及中小型项目。

燃机通胀逻辑继续演绎，SOFC 商业化提速打开成长空间。(1)燃机：截至 2026Q2，GEV 燃机正式积压与锁槽订单合计达 116GW、同比+115%，西门子能源合计达 87GW、同比增长 74%，三菱重工 FY25 期末在手重燃订单达 74 台，三大主机厂订单均处于历史高位，供应链紧张及交期延长持续强化行业通胀逻辑。(2)SOFC：电解质支撑型凭借结构稳定、长期耐久性强及商业化成熟度相对较高，与当前 AIDC 长期可靠供电需求匹配度最高；随着行业龙头 BE 迎来业绩拐点，SOFC 国内产业链同样有望迈向规模化应用并受益于行业上行周期。

投资建议：①燃气轮机：重点推荐北美燃机在手订单超 26 亿美元+2027 年交付量有望接近 2GW+具备稀缺机头资源和成撬能力的【杰瑞股份】；卡位高壁垒热部件领域的【万泽股份】【应流股份】；燃机整机质量优越的【中国动力】等。②SOFC：建议关注深度绑定 BE 的【春晖智控】，具备 SOFC 全产业链能力的【三环集团】，掌握连接体原材料核心环节的【振华股份】。

风险提示：AI 数据中心投资不及预期、国际贸易摩擦、产能爬坡不及预期。

【玻璃基板】深度报告：材料变革与封装工艺升级共振，产业化临界点将近

AI 算力需求高增推高带宽需求，玻璃基板有望开启先进封装的“材料革命”，产业链设备与材料环节率先受益。后摩尔时代芯片制程红利趋缓，先进封装成为提升系统性能的关键路径；根据 Yole 数据，2024 年全球先进封装市场约 460 亿美元、同比+19%，2030 年有望达 794 亿美元、CAGR 约 9.5%。随着算力芯片与 HBM 高带宽存储协同要求不断提高，硅基与有机中介层/载板在大尺寸、翘曲控制、高频损耗等方面逐渐触及瓶颈，玻璃凭借机械尺寸稳定、CTE 可调、介电损耗低、表面平整、且可面板级大尺寸加工等本征特性，成为破局材料。当前时点产业共识正在形成：英特尔于 2026 年第 76 届 ECTC 发布玻璃芯基板量产技术突破，台积电推进面板级 CoPoS，康宁推出 Glass Bridge 玻璃桥 CPO 方案，京东方在 5 月 20 日公告与康宁合作、玻璃基封装载板试验线已通线并送客户认证，沃格光电、蓝思科技等亦密集布局，海内外龙头共同验证玻璃基板的产业化方向。

玻璃基板落地三大方案，层层递进打开设备与材料空间。1)面板级封装 (CoPoS) 方案：玻璃作为方形临时载具，承载 CoWoS-L 式 RDL 重布线，在玻璃上打 TGV 玻璃

通孔、金属化后制备 RDL，以 TGV 垂直互连；该方案相比圆晶圆更具经济性、支持面板级大尺寸，CTE 可调以改善翘曲，并可掏槽内嵌元件、演化出 5.5D 封装。2）玻璃芯封装板方案：以玻璃替代传统覆铜板有机核心层，机械刚性与介质损耗 Df 优于有机材料，更好满足高频高速传输。3）CPO 玻璃桥方案（康宁）：在玻璃内部制作光波导，直接连接 PIC 与光纤、取代 FAU，显著降低耦合对位难度，并可与玻璃基板工艺相结合。三条主线的共同点是把价值量集中导向 TGV 打孔、金属化电镀、RDL 布线等前道图形化与镀铜环节。

核心增量在加工设备与材料：TGV 打孔（激光/刻蚀）、金属化与电镀、RDL 光刻是玻璃基板产业化的三大关键工艺环节。 TGV 成孔以激光钻孔（紫外超快激光优于 CO₂）、激光诱导改性+湿法刻蚀、感光玻璃光刻为主流路线；金属化以磁控溅射种子层配合化学镀/电镀实现全铜填充；RDL 沿用硅基的电镀法与大马士革法，对直写光刻、垂直电镀与电镀化学药水提出更高要求。当前瓶颈集中在高深宽比成孔、电镀无空隙填充与玻璃开裂控制，正是国产设备与材料企业切入的窗口期。

投资建议：沿“激光—光刻—电镀”三条工艺主线，关注玻璃基板产业化中的国产设备与材料机会。（1）激光钻孔/改性设备：TGV 成孔是玻璃基板的关键工艺，相关标的为大族数控、帝尔激光、德龙激光；（2）光刻/直写设备：RDL 高密度布线与感光玻璃光刻环节，相关标的为芯碁微装；（3）电镀设备与电镀化学品：TGV 铜填充与 RDL 电镀是价值量核心环节，相关标的为东威科技、洪田股份、三孚新科。

风险提示：下游巨头玻璃基板导入进度不及预期；关键工艺良率突破不及预期；先进封装及 AI 算力需求不及预期。

【冰轮环境】深度报告：中国制冷工业奠基企业，AIDC 冷源赛道打开成长空间

中国制冷工业奠基企业，AIDC 新赛道打开成长空间。公司深耕制冷装备近 70 年，已形成低温冷冻+暖通空调+环保制热+能化装备多元化布局。子公司顿汉布什为公司切入海外 AIDC 高端冷水机组市场的核心平台，具备北美本土品牌认证、客户渠道及项目基础等稀缺优势。未来随着 AIDC 冷水机组需求持续释放，冰轮有望依托高端冷源产品+国内供应链协同，进一步强化业绩弹性。

工业制冷+中央空调双轮驱动，冷热主业基本盘稳健。（1）制冷：食品冷链端，受益于冷链仓储扩容、预制菜放量及政策支持，制冷压缩机组和速冻机需求保持稳健；能源化工端，行业需求由新增扩产转向存量技改，冰轮凭借多场景非标项目经验和系统集成交付能力，有望获取结构性增量订单。（2）暖通：国内中央空调市场维持千亿级体量，海外空间更为广阔，收购顿汉布什补强公司在高端冷水机组领域及渠道的布局。整体来看，公司传统冷热主业需求稳固，工业制冷规模优势、非标交付能力与体内高端冷源平

台共同支撑业绩增长。

AIDC 冷源需求持续强化，顿汉布什体系具备高度稀缺性。Rubin 架构虽提高了进液温度，但并不改变冷水机组配置逻辑。在散热需求总量提升、冗余配置要求及区域高温气候约束下，AIDC 一次侧冷机需求仍会持续释放。同时，PUE/TCO 要求推动冷机从传统螺杆式向更高价值量的磁悬浮离心式升级，构筑产品结构通胀弹性。顿汉布什作为北美本土冷水机组品牌，可大幅降低冰轮出海的合规认证与渠道建设成本，叠加公司国内供应链与马来西亚产能支撑，有望承接 AIDC 订单外溢，助力公司中长期业绩上行。

盈利预测与投资建议：公司作为国内制冷龙头，食品冷链、能源化工、中央空调基本盘稳健，通过核心压缩机自主配套+非标系统集成+海外本地化交付能力构筑显著竞争壁垒，有望持续受益 AIDC 驱动的冷源需求上行趋势。我们预计公司 2026-2028 年归母净利润为 8.3/12.2/17.0 亿元，当前市值（截至 2026/7/2）对应 PE 分别为 63/43/31X，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：下游需求波动风险、AIDC 订单不及预期、海外经营及交付风险等

【存储测试机】专题：AI 算力催生 HBM 带动测试机新需求，国产设备商加速突破

存储持续涨价&两存上市在即，看好存储未来扩产持续性。自 2024 年底以来，在 AI 算力需求拉动下，DRAM 与 NAND Flash 现货价格均进入快速上行通道，DDR4(8Gb) 2024 年底到 2026 年 6 月涨幅超 17 倍，DDR5(16Gb) 2025 年 11 月至 2026 年 6 月底涨幅约 4.9 倍。长鑫存储 2025 年营收 618 亿元，2026Q1 营收同比+719%，产能利用率 2024Q1 以来长期维持 90%以上，资本开支持续高位。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著，后续扩产空间广阔。

AI 算力催生 HBM 需求，HBM 成为 AI 芯片主流方案。AI 服务器出货量 2023-2025 年接近翻倍，Trendforce 预计 2026 年达 275 万台。HBM 凭借高带宽、低延迟、低功耗优势成为应对内存墙的核心技术，在 AI 服务器 BOM 中价值量占比快速提升。2025 年 HBM 市场基本由 SK 海力士（占据市场份额 58.3%）、三星和美光占据，海外龙头已陆续实现 HBM4 量产，国内长鑫存储预计 2027 年实现 HBM3e 量产。

HBM 堆叠对测试机提出 KGSD 等新需求，存储测试机需求量价齐升。HBM 采用 3D 堆叠架构，测试重心前移至 KGSD 测试环节，测试道数由传统 DRAM 的 3-4 道提升至 15 道以上，存储测试机需求约为传统 DRAM 的 5-6 倍。HBM 对测试设备在供电能力、时序精度、高并行测试能力及测试算法等方面均提出更高要求。

存储测试机国产化率极低，国产替代空间广阔。存储测试机市场 2025 年由爱德万（占据市场份额 61%）和泰瑞达（占据市场份额 24%）主导，国内国产化率仅 8-10%，

显著低于其他测试设备细分赛道，是半导体设备自主可控的重要短板。地缘政治环境复杂化背景下，国产替代逻辑强化，国内厂商正加速布局。

投资建议：重点推荐国内存储测试机领先布局厂商，重点推荐【长川科技】、建议关注【精智达】、【联讯仪器】、【悦芯科技（未上市）】。

风险提示：封测设备需求不及预期、技术研发不及预期、行业竞争加剧。

【光模块】测试仪器专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代

光模块等 AI 基础设施需求爆发，配套测试仪器量价齐升：2025 年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，其中光模块作为 AI 核心基础设施，技术升级和扩产提速。光模块研发、量产环节均需检测，尤其量产环节客户基本要求全检，随光模块速率升级（800G→1.6T→3.2T）、形态演进（可插拔→CPO），配套的测试设备精度提升、测试时间拉长，价值量和需求量将翻倍。其中，采样示波器为光模块测试核心仪器，根据我们测算其 2027 年市场规模预计突破 200 亿元。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安立等垄断，国产化率不足 20%。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求，供需缺口和国产替代趋势下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。

芯片为测试仪器卡脖子环节，供需缺口、政策催化加速国产替代：芯片为电子测量仪器核心零部件，承担着信号转换、调制解调、数字处理与编码解码等关键功能，其发展水平决定了测试仪器设备的功能实现及性能边界。由于测试仪器细分赛道多而单赛道天花板低、高端仪器的核心芯片专业性强、性能要求高、研发成本高昂，市面上通常不存在成熟的商用芯片，倒逼厂商自研。以采样示波器为例，10GHz 和 30GHz 阶段，仪器厂通过采购成熟芯片、优化硬件板卡和算法软件，即可满足性能需求，而在 50GHz 及以上阶段，商用放大器芯片已无法支持采样示波器性能要求。1.6T 光模块的信号基频达到了 56GHz，1.6T 时代仅有自研芯片能力的厂商才可入局。

看好与国产链深度绑定、已有技术布局的国产测试仪器龙头：推荐普源精电：国内唯一搭载自研 ASIC 数字示波器商业化落地的企业。建议关注（1）联讯仪器：全球第二家推出业内最高水平 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商；（2）华兴源创：收购普赛斯布局示波器、源表和误码仪；（3）华盛昌：收购伽蓝特布局光源、光功率计、误码测试仪和光时钟恢复仪；（4）鼎阳科技：国内头部电子测量仪器供应商，可为光模块、AI 芯片等下游客户提供测试仪器；（5）优利德：国内头部测试测量仪器供应商，收购信测通信布局通信光功率计、光时域反射仪、光纤传感和电磁测量。

风险提示：新品推出不及预期、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧。

【PCB】设备专题报告：mSAP 工艺应用场景拓展，设备股迎成长新机遇

AI 硬件升级驱动 PCB 性能要求提升，mSAP 工艺应用边界持续拓宽，迎来扩产放量。伴随 1.6T 光模块、CoWoP 工艺及 NPO 的加速渗透，mSAP 工艺正快速向光模块、先进封装等场景拓展。1.6T 光模块量产落地促使 PCB 线路精度要求提升至 15 μ m 级别，布线密度大幅提升。传统 Tenting 工艺难以满足高密度互联需求，mSAP 工艺通过超薄种子铜层、图形电镀、闪蚀等流程，可实现陡直线路侧壁与高精度线宽控制，能够适配高密度布线与低信号损耗需求，成为高阶 PCB 的主流升级方案。长期来看，CoWoP、NPO 等下一代封装与光学技术演进，将进一步推进 PCB 载板化需求，持续打开 mSAP 工艺的市场空间。下游 PCB 厂商加速 mSAP 产能布局，鹏鼎、深南、兴森、景旺、红板、方正等头部厂商均投资规划新增多条 mSAP 产线，直接拉动高阶设备需求增长。

mSAP 工艺驱动设备技术升级，钻孔/电镀/LDI/成型四大核心环节受益。mSAP 工艺突破了传统减成法的精细线路局限，对多环节核心设备提出更高阶的技术要求，微孔加工精度、曝光对位精度、电镀铜厚均匀性等技术门槛大幅抬升：①钻孔环节：孔径缩小至 50 μ m 左右，超快激光钻孔机具备更强的小孔加工能力，成为解决 CO₂ 激光钻局限的更优解决方案；②电镀环节：要求铜厚均匀性偏差控制在 $\pm 5\%$ 以内，垂直连续电镀（VCP）设备、水平三合一设备价值量大幅攀升；③曝光环节：线宽线距缩小至 15 μ m，倒逼激光直接成像（LDI）设备成像精度与对位精度要求提升；④成型环节：针对 1.6T 光模块等小面积复杂结构，CCD 锣机等高精度成型设备成为刚需。技术升级带动设备单价与壁垒同步提升。

国产厂商突破技术壁垒，国产替代与批量交付正加速兑现。国内厂商已实现多环节技术突破，逐步进入头部客户供应链。①大族数控：覆盖钻孔、曝光、成型全流程，超快激光钻孔机已在头部客户实现批量化生产，CCD 锣机成为 1.6T 光模块成型的优质方案；②东威科技：mSAP 移栽式 VCP 及水平镀三合一设备量产领先，打破国外垄断。国产设备凭借产品性能、交付周期与本地化服务优势加速替代；③芯碁微装：作为 PCB 直写光刻龙头，MAS6P 系列 LDI 设备解析能力达 6/6 μ m，生产效率领先国际同类产品；④洪田股份：通过收购东莞速远、控股洪镭光学，布局高端电镀与光刻环节，解决 mSAP 高孔径比多层板填孔工艺，可满足 HDI 及 IC 封装基板的 mSAP 工艺需求。

投资建议：推荐【大族数控】【东威科技】【芯碁微装】【洪田股份】。

风险提示：宏观经济波动风险，PCB 工艺进展不及预期风险，算力服务器需求不及预期风险。

【蓝思科技】深度报告：大客户创新大年开启价值量拐点，新兴赛道多点布局打开长期成长空间

深耕 AI 端侧应用 20 年，大客户创新大年与新兴赛道共振：公司以消费电子精密制造起家，历经 20 余年深耕构筑平台型制造能力，形成从防护玻璃、金属结构件到整机组装的全链条垂直整合布局。苹果折叠屏 iPhone 有望于 2026 年正式推出，作为苹果消费电子核心供应商，公司将充分受益于新品带来的单机价值量提升。同时，公司持续向人形机器人、AI 眼镜、AI 服务器液冷、商业航天等新兴领域延伸，多赛道协同打开中长期成长空间。

智能手机与电脑业务为核心基本盘，AI 端侧景气改善带来业绩修复：智能手机与电脑类业务 2025 年实现收入 611.8 亿元，占总营收比重达 82%，是公司最核心的收入来源。公司深度绑定苹果供应链，产品覆盖防护玻璃、金属中框、触控模组、蓝宝石镜片等核心零部件。彭博社预计苹果折叠屏于 2026 年正式推出，折叠屏设备对精密玻璃、铰链结构件、触控模组的要求均大幅高于传统直板机，单机价值量有望较传统机型实现可观提升。公司已具备航天级 UTG 材料量产能力，并在 3D 曲面玻璃、超薄盖板玻璃领域持续深耕，技术壁垒深厚，有望充分分享折叠屏放量带来的价值量增长红利。

深度绑定特斯拉供应链，人形机器人批量交付打开第二成长曲线：AI 智能化驱动背景下，人形机器人作为最佳硬件载体，未来成长空间广阔。公司把握人形机器人产业发展机遇，积极拓展机器人领域版图，国内方面深度绑定智元，并与优必选，灵心巧手，越疆机器人等企业合作开发机器人产品。海外方面公司已进入特斯拉 Optimus 供应链体系，在灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器等关键模组上实现量产能力储备。

拟并购元拾打通 AI 服务器液冷产业链，有望深度受益算力基建扩张：为满足 AI 算力需求，服务器性能跃升直接导致芯片功耗与机柜功率密度急剧攀升，液冷成为服务器标准解决方案。2026 年公司拟收购元拾科技，从而获取英伟达机架产品、液冷模组的 RVL/AVL 认证，形成完整的二次侧散热解决方案，精准切入英伟达下一代 Rubin GPU 集成化需求。

UTG 材料前瞻布局，覆盖商业航天全链条：公司航天级 UTG 超薄柔性玻璃是柔性太阳翼封装的核心材料，同步布局太空轻量化机柜、TGV 玻璃基板等产品，平台型制造能力赋予公司持续切入高附加值新赛道的能力。

盈利预测与投资评级：考虑到折叠屏 iPhone 量产带动公司单机价值量提升及新兴赛道快速放量，2026E-2028E 归母净利润分别为 43.3/65.7/82.0 亿元，当前股价（截至 2026 年 6 月 22 日）对应动态 PE 分别为 68/45/36x，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险；折叠屏渗透不及预期风险；客户集中风险。

【长川科技】深度报告：国产 SoC 测试机龙头，看好公司份额持续提升&存储测试机第二曲线

AI 算力芯片放量，SoC 测试机进入量价齐升周期。AI/HPC 芯片向先进制程、Chiplet 及先进封装持续演进，测试步骤和测试时长显著增加。全球 SoC 测试机市场规模预计由 2023 年的 33 亿美元增长至 2026 年的 91 亿美元，2023-2026E CAGR 达 40%。

国产算力崛起带动国内 SoC 测试需求快速提升。当前海外 SoC 测试需求已以 AI 芯片为主，而国内仍以手机芯片为主。随着华为昇腾、寒武纪、海光等国产算力芯片持续放量，中国 AI 芯片测试需求占比有望快速提升，带动国产测试设备需求增长。

自主可控趋势强化，测试机国产替代空间广阔。全球测试机市场长期由爱德万和泰瑞达主导，其中爱德万市占率达 65%（销售额口径）。美国持续升级半导体限制叠加中日关系变化，自主可控重要性进一步提升。按 2025 年市场测算，仅测试机领域国产替代空间即超过百亿元。

先进封装扩产带来测试设备增量需求。盛合晶微、长电科技、通富微电、华天科技等头部封测厂持续扩张先进封装产能。测试机通常为封测厂资本开支占比最高设备之一，先进封装扩产将持续拉动测试设备需求增长。

HBM 推动存储测试机进入新周期。HBM 采用多层 DRAM 堆叠及 TSV 结构，新增 KGSD、TSV、CoW 等测试环节，测试复杂度显著提升。随着 AI 训练卡对 HBM 需求快速增长，存储测试机迎来需求扩张与技术升级双重驱动。

投资建议：我们基本维持公司 2026-2028 年归母净利润分别为 21.5/30.4/41.5（原值 22.8/31.2/42.3）亿元，2026-2028 年当前股价（截至 2026/6/15）对应动态 PE 分别为 66/47/34 倍；公司的 SoC 测试设备和存储测试设备技术国内领先，未来将受益于半导体测试领域国产化进程的不断推进，综合来看成长性较为突出，维持“买入”评级。

风险提示：封测设备需求不及预期，技术研发不及预期，行业竞争加剧。

【锡膏行业】深度报告：AI 时代工业血液，光模块新增需求带动“量价齐升”

锡膏系电子联装环节核心耗材：电子锡焊料主要用于电子联装环节，是 PCB 裸板生产完成后，将电子元器件（电阻、电容、芯片等）等零散零部件互联的制造过程，电子锡焊料下游应用领域广泛，主要包括消费电子、通信和计算机等。根据 QY Research 报告，2023 年中国电子级锡焊料市场规模为 42.08 亿美元。锡膏系电子锡焊料的细分品类，主要用于微电子精密焊接，下游包括半导体封装、mini-led 等。锡膏由锡合金粉与助焊膏搅拌混合而成。随着先进封装的发展，元器件逐步缩小，所需锡膏的粉末颗粒也越小，锡膏正逐步向精细化、绿色化和低温化发展。

光模块高端化升级，带动锡膏“量价齐升”：光模块生产过程中存在多类焊接及电气互联环节，主要包括 PCBA 贴装焊点、光器件内部精密焊点以及外壳结构封装固定。光模块升级对锡膏的拉动可以拆为“量”和“价”两条主线。1) 量提升：一是 AI 算力需求推动高速光模块出货增长；二是速率提升带来通道数、DSP 基座、光芯片、电芯片、无源器件及连接器数量增加，单模块锡点数量和用膏量同步提升；2) 价提升：焊点尺寸和间距持续微缩，封装形态从板级组装向 2.5D/3D 高密度互联演进，推动锡膏等级由 T5/T6 向 T7/T8 升级，同时对低残留、热稳定、抗蠕变和低信号衰减提出更高要求，锡膏价格快速提升。

竞争格局：外资为主，国产加速替代。半导体封装高端锡膏主要外资主导。全球半导体封装焊膏市场呈现高度集中态势，以海外龙头为主，主要包括美国爱法、美国钎泰、日本千住和德国贺利氏。国内来看，高端超细锡膏产能极度稀缺，以唯特偶主导，未来随着光模块对高端锡膏产能需求爆发，海外产能供不应求，国产锡膏有望加速国产替代。

相关公司：光模块速率升级，PCBA 焊点数量提升，带动锡膏用量提升。同时锡膏向精细化发展，粉径缩小，价值量提升；此外锡膏难度大，过去多用于半导体，且以海外为主，竞争格局良好，需求爆发下国产公司加速海外替代。建议关注锡膏行业龙头【唯特偶】【华光新材】，锡粉供应商龙头【有研粉材】。

风险提示：宏观经济变化及下游行业波动的风险，市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险。

【PCB 设备材料】行业深度报告：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇

AI 拉动 PCB 扩产，上游原材料缺口紧张。25 年起，PCB 行业产能日益趋紧，主流厂商加速扩产，资本开支端反应明显，2025 年 9 家头部 PCB 企业资本开支达 267 亿元，同比+111%，2026Q1 资本开支达 125 亿元，同比增速达到 182%，仍在加速。现阶段扩产仍主要以胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股为主，我们判断后续深南电路、景旺电子、方正科技、广合科技等有望接棒加速。在 PCB 中，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了 PCB 物理基础。①铜箔：铜箔是 PCB 上的导电层，是负责导电的“公路网”。它的核心作用是经过 LDI 和刻蚀后留下的线路可以传输电信号。②电子布：电子布由极细的玻璃纤维编织而成，主要为电路板提供机械强度和刚性，是提供强度的“钢筋”，防止 PCB 出现弯曲与形变。③树脂：PCB 中通常使用的是环氧树脂，是负责粘合的“水泥”，一方面结合电子布、铜箔；另一方面绝缘防止发生短路。

原材料价格飞涨，国内厂商加速扩产实现替代。建滔积层板 2025 年以来经历了 7 次涨价，主要因上游原材料需求紧张涨价拉动。HVLP 铜箔与高端电子布过往供应商主要为日韩企业。HVLP 铜箔的主力供应商包括日本三井、日本古河、日本福田、韩国斗

山,电子布的主力供应商包括日本日东纺、日本旭化成。算力建设的非线性增长带动 PCB 材料需求快速提升,而日韩企业扩产意愿弱速度慢,供需缺口持续拉大。目前进口铜箔设备与电子布设备均处于供不应求状态,看好国内企业扩产带动设备国产机遇。目前核心设备如日本新日铁与三船的铜箔表面处理机,以及丰田、津田驹电子布织布机均处于供不应求状态,看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。1 铜箔设备重点增量为表面处理机。①溶铜罐:将高纯度电解铜溶解并制备成符合要求的硫酸铜电解液;②阴极辊:通过电解反应将铜离子在阴极辊表面沉积为原箔,对表面光洁度要求较高;③生箔机:为电解阳极,在高速旋转的阴极辊表面连续析出铜箔;④表面处理机:在保持极低粗糙度的前提下通过电镀工艺在铜面上均匀生长出极细微的颗粒。表面处理环节是国内外铜箔企业技术差距最大的领域,也是制约国内 HVLP 铜箔产能扩张的主要瓶颈。

电子布设备重点卡脖子环节为喷气织布机。①池窑拉丝线:铂铑合金漏板与高速拉丝机搭配使用,生产玻纤丝线;②捻丝机:单丝直径太细,需要经捻丝机并合捻丝,成为可用于织布的电子纱;③喷气织布机:利用压缩空气作为引纬介质,通过气流牵引纬纱穿越梭口,实现高速、高精度织造,可实现电子布对微米级厚度精度和零瑕疵的苛刻要求。织布机非常依赖进口品牌。丰田 JAT910 系列织机是唯一能稳定量产 1080 及以下超薄电子布的设备,目前泰坦股份与卓郎智能正在验证,有望实现国产替代。

投资建议:铜箔设备建议关注【洪田股份】【泰金新能】;电子布设备建议关注【泰坦股份】【卓郎智能】。

风险提示:宏观经济波动风险,PCB 工艺进展不及预期风险,算力服务器需求不及预期风险。

【北方华创】深度报告:平台化半导体设备龙头,受益于下游资本开支扩张&国产化率提升

看好先进逻辑&存储加速扩产:晶圆厂扩产方面,我们预计 2026-2027 年内资晶圆厂资本开支持续扩张。1)逻辑端:中芯国际自 2023 年起产能利用率稳步提升,2025Q3 已升至 95.8%;国内厂商先进逻辑工艺陆续突破,有望加速落地先进制程产能。2)存储端:2024 年全球 NAND/DRAM 存储器市场中,我国长江存储&长鑫存储市占率分别仅为 5/5%(销售额口径),后续仍待突破,我们预计 2026 年长江存储与长鑫存储合计新增 10-12 万片/月产能,重点聚焦于 3DNAND 与 HBM 制程,投资总额有望达 155-180 亿美元。根据 SEMI 预测数据,2026-2027 年全球晶圆厂设备支出约 8827/9471 亿元,分别同比增长 9/7%。叠加自主可控需求,我们预计 2026-2027 年中国大陆晶圆厂设备销售额将达 4414/4736 亿元,分别同比+21/7%。

海外限制不断收紧,半导体设备国产替代诉求迫切:美日荷持续强化对先进制程设

备出口限制，国内晶圆厂在自主可控导向下加快国产设备导入进程。2024 年中国大陆半导体设备销售额达 495 亿元，全球占比 42%，连续四年为全球第一大设备市场。我们预计 2025 年半导体设备国产化率提升至 22%，其中刻蚀、清洗、CMP 等环节已实现阶段性突破，光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等高端环节国产化率仍低于 25%，替代空间广阔。

内生+外延不断拓展公司产品线，彰显半导体设备龙头地位：作为国产半导体设备领军者，公司持续受益设备国产替代+产品线延展。1) 刻蚀设备：我们预估 2027 年中国大陆半导体干法刻蚀设备市场规模达到 895 亿元。公司在 ICP 领域主导国内市场，同时积极布局 CCP 领域，市占率持续提升，高深宽比刻蚀取得率先突破。2) 薄膜沉积设备：我们预估 2027 年中国大陆半导体薄膜沉积设备市场规模将达 1089 亿元。公司 PVD 市场竞争力显著，持续拓展 CVD、ALD 等产品系列，已跻身国内第一梯队，不断打开成长空间。3) Track 设备：我国涂胶显影市场规模 2025 年有望达 143.7 亿元、2025 台。芯源微是国内首家具备量产交付能力的企业，公司通过获得芯源微股权填补 Track 产品空白，有望充分受益于 Track 国产替代进程。4) 热处理设备：我们预计 2027 年中国大陆热处理设备市场规模约为 210 亿元，公司已具备较强市场竞争力，25H1 该业务收入 10 亿元。5) 清洗设备：我们预计 2027 年中国大陆市场规模约 243 亿元，公司收购 Aktron 完善清洗设备产品线，产品体系不断完善，已成功覆盖槽式、单片清洗设备。6) 其他：公司积极拓展离子注入机、电镀设备等品类，平台化布局持续深入。

盈利预测与投资评级：考虑到公司 2025-2027 年集中进行研发投入，我们下调 2025-2027 年归母净利润为 58.50（原值 65.1）/77.84（原值 88.0）/102.39（原值 110.9）亿元，分别同比+4%/+33%/+32%。当前股价（截至 2026/1/23）对应动态 PE 分别为 63/48/36 倍，考虑到公司平台化布局持续推进，维持“买入”评级。

风险提示：半导体行业投资不及预期、设备国产化不及预期、海外限制加剧风险

4. 行业重点新闻

燃气轮机：西门子能源发布 2026 财年第三季度财报，斩获 73 台燃机订单

2026 年 8 月 5 日，西门子能源发布 2026 财年第三季度财务报告。本季度是西门子能源公司迄今为止最高营收的季度，订单量、营收及盈利能力均创下历史新高。

2026 年第三季度，订单总额达到创纪录的 179 亿欧元，这一增长主要得益于 Gas Services 部门创下的新订单记录，以及电网技术与工业转型部门的显著增长。截至本季度末，订单积压额已增至 1620 亿欧元。营收增长 18.5%，达到 114 亿欧元。净利润达到 11.88 亿欧元，较去年同期增长 70.5%。

第三季度，Gas Service 板块创下订单新纪录，新接订单规模 15GW，对应订单金额

99.67 亿欧元，同比增长 61.9%，主要驱动因素是美国市场的需求（包括与数据中心相关的大额订单）以及中东和亚洲地区对新建电厂的订单，传统电力市场依旧是主要增长动力。本季度板块完成装机交付规模 6GW。

本季度，西门子能源共计斩获 73 台燃气轮机订单，包含 25 台重型燃气轮机、48 台工业型燃气轮机。依托强劲拿单表现，西门子能源在全球 100 兆瓦及以上燃气轮机市场的份额提升至 42%。

盈利转化层面，Gas Service 板块收入达到 37.56 亿欧元，较去年同期增长 20.8%。订单到账率（Book-to-Bill ratio）为 2.65，订单积压额增至 730 亿欧元，长期业绩确定性充足。

来源：燃气轮机聚焦

太空算力：SpaceX AI 服务将独家基于英伟达，预计年底算力超 2 吉瓦

SpaceX 首席执行官马斯克于当地时间 8 月 4 日在公司首次财报电话会上宣布，未来 SpaceX 的 AI 服务将独家基于英伟达系统运行。马斯克称，英伟达 VeraRubin 架构被公司认定为“最佳 AI 计算架构”。他同时透露，SpaceX 预计到今年年底，计算能力将超过 2 吉瓦，明年底前将接近 10 吉瓦。公司计划在地面端和太空端部署英伟达 Vera Rubin NVL72 机架级系统，并将该系统应用于“Starmind”卫星项目。马斯克表示，相关卫星预计于明年开始发射。

来源：金融界

5. 公司新闻公告

应流股份（603308.SH）：关于提前赎回“应流转债”的公告

2026 年 8 月 5 日，应流股份发布关于提前赎回“应流转债”的公告，公司股票自 2026 年 7 月 16 日至 8 月 5 日连续 15 个交易日收盘价不低于“应流转债”转股价格（30.31 元/股）的 130%（即 39.40 元/股），触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款。此前，公司曾在 2026 年 4 月 15 日因类似情形决定不行使赎回权，并承诺未来三个月内（至 2026 年 7 月 15 日）不赎回；自 7 月 16 日起重新计算触发周期，本次再度触发后，公司于 2026 年 8 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权。

本次赎回价格为债券面值 100 元/张加当期应计利息，利息按公式 $IA=B2 \times i \times t/365$ 计算，其中 i 为当年票面利率（2026 年为第三年，利率 0.60%）， t 为自上一付息日至赎

回日的实际天数。投资者若未在规定期限内转股或卖出，将被强制以 100 元/张赎回，面临显著投资损失。转股价格为 30.31 元/股，若按当前股价测算，转股收益远高于赎回对价，但控股股东及一致行动人已全部清仓，合计卖出 5,214,670 张，占发行总量约 34.76%。

“应流转债”发行总额 15 亿元，期限 6 年（2025 年 9 月 19 日至 2031 年 9 月 18 日），转股期自 2026 年 3 月 25 日起。公司因 2025 年度利润分配，转股价格由 30.47 元/股下调至 30.31 元/股，自 2026 年 7 月 10 日生效。保荐机构核查确认本次赎回程序合法合规，符合《可转换公司债券管理办法》及上交所相关自律规则。公司将发布赎回实施公告，明确登记日、付款时间等细节，提示投资者注意风险。

普源精电（688337.SH）：2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

2026 年 8 月 7 日，普源精电发布 2026 年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予 80.00 万股限制性股票，占公司总股本 0.36%，全部来源于二级市场回购股份，无预留权益，有效期 48 个月，覆盖 36 名激励对象，占员工总数 5.15%，含外籍员工，旨在强化核心技术与国际化人才激励。激励对象分为事业合伙人与企业合伙人，两类人员分别对应第一类与第二类限制性股票，授予价格依据前 60 日均价 50%~65% 确定，分别为 30.94 元/股、34.04 元/股（第一类）和 37.13 元/股、40.23 元/股（第二类）。

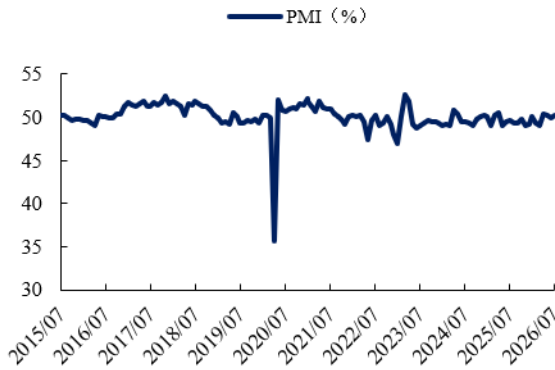
公司层面业绩考核分三个归属期（2026-2028 年），目标值为每年营业收入或净利润增长率不低于 35%，触发值为不低于 20%或 25%。个人层面考核结果为 A++至 A-时归属比例为 100%，N 级为 0%，考核标准统一适用于两类激励对象。解除限售与归属安排均为三批次：40%、30%、30%，分别于授予后 12、24、36 个月起分批生效，激励对象需满足 12 个月以上任职期限方可归属。

股份支付总费用预计 960.86 万元，按四年摊销，2026-2029 年分别确认 150.53 万元、514.90 万元、216.29 万元、79.13 万元。第一类与第二类限制性股票摊销成本合计分别为 479.80 万元与 481.06 万元，会计处理依据《企业会计准则第 11 号》与《第 22 号》，公允价值采用授予日收盘价或 B-S 模型测算。激励对象获授股票在限售/归属前不得转让、担保或偿还债务，归属后禁售规则遵循《公司法》《证券法》。

来源：Wind

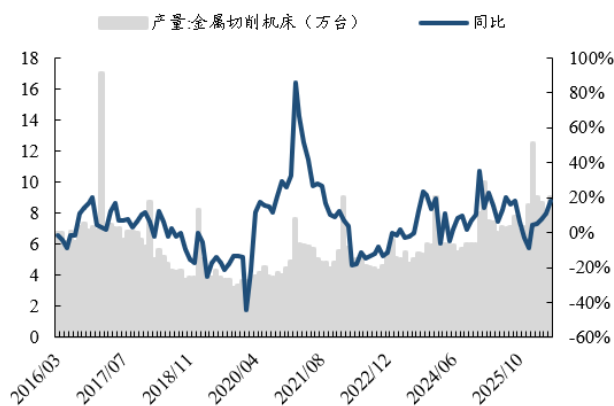
6. 重点高频数据跟踪

图1: 2026 年 7 月制造业 PMI 为 49.2%，环比下降 1.1pct



数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图3: 2026 年 6 月金切机床产量 9.0 万台，同比+18%



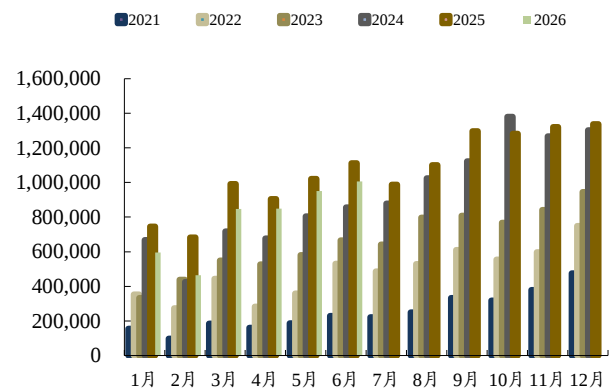
数据来源：Wind，东吴证券研究所（每年 1-2 月数据为累计值，其他月份为当月值）

图2: 2026 年 6 月制造业固定资产投资完成额累计同比-1.2%



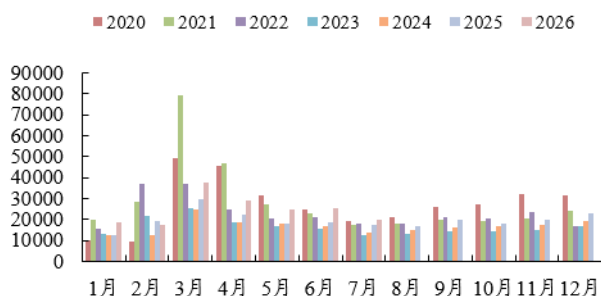
数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图4: 2026 年 6 月新能源乘用车销量 100.7 万辆，同比-9%（单位：辆）



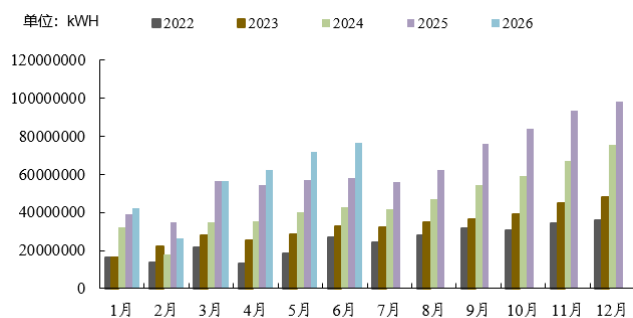
数据来源：乘联会，东吴证券研究所

图5: 2026 年 7 月挖机销量 2.0 万台,同比+14% (单位:台)



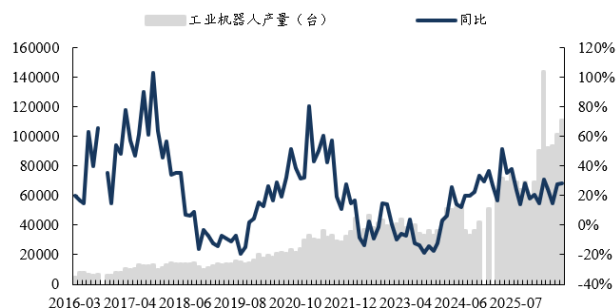
数据来源: 工程机械协会, 东吴证券研究所

图7: 2026 年 6 月动力电池装机 76.5GWh,同比+31%



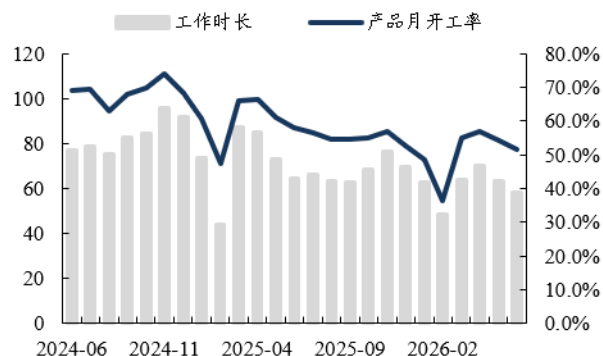
数据来源: GGII, 东吴证券研究所

图9: 2026 年 6 月工业机器人产量 11.1 万套,同比+28%



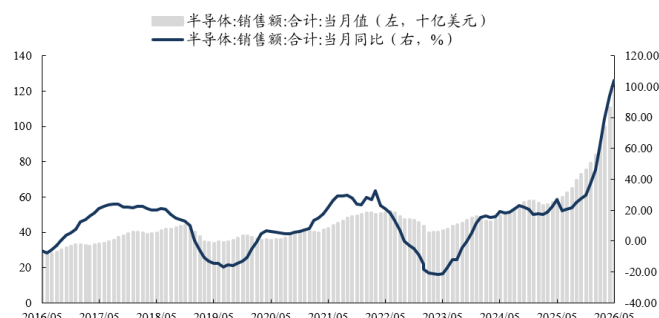
数据来源: 国家统计局, 东吴证券研究所

图6: 2026 年 6 月国内挖机开工时长为 58.1 小时, 同比-10% (单位: 小时)



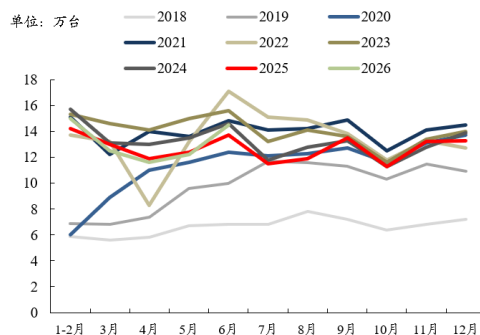
数据来源: 工程机械协会, 东吴证券研究所

图8: 2026 年 5 月全球半导体销售额 1206.1 亿美元, 同比+104%



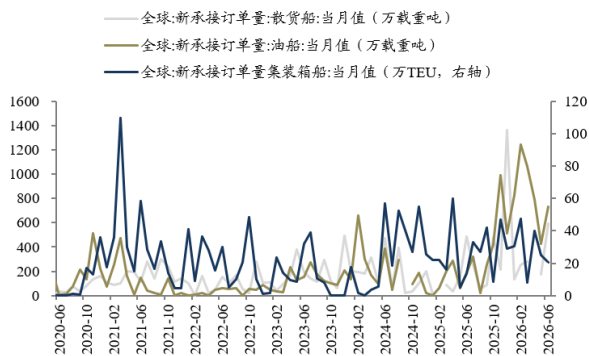
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图10: 2026 年 6 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.5 万台,同比+9%



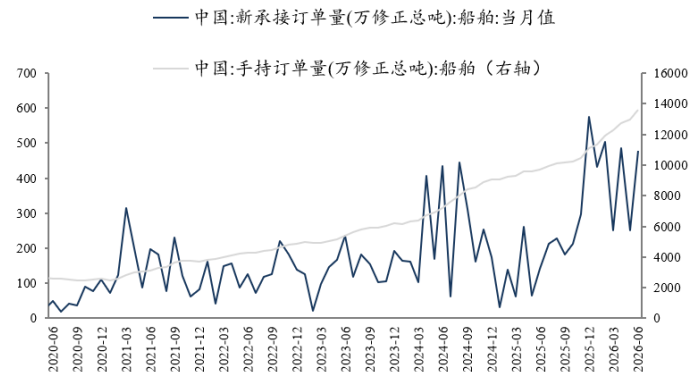
数据来源: 国家统计局, 东吴证券研究所

图11: 2026年6月全球集装箱船/油船/散货船新接单量同比分别+53%/+291%/+21%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图12: 2026年6月我国船舶新承接/手持订单同比分别+238%/+41%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

7. 风险提示

（1）下游固定资产投资不及市场预期:

制造业景气度复苏存在不及预期可能，将可能导致下游固定资产投资减少，从而影响制造业企业利润。

（2）行业周期性波动风险: 制造业存在行业周期性波动，将对制造业企业经营及股价表现造成影响。

（3）地缘政治及汇率风险: 出口系制造业重要需求来源，但在地缘政治影响下，国际关系将对企业出口造成重大影响，此外汇率波动也将对制造业企业盈利能力产生影响。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>